

迅得機械股份有限公司 函



地址：320 桃園市中壢區中正里榮民路 421 號
承辦人：人資部 鄭曉菁
聯絡電話：(03)435-6870 分機 369
電子郵件：May.cheng@saa-symtek.com

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國一一二年六月二十九日
發文字號：迅管字第 112010 號
速別：最速件
附件：如說明四

主旨：為本公司辦理【智慧製造科技論文獎】競賽活動，敬請惠予協助公告並推薦及鼓勵指導教授、所屬學生踴躍投稿報名參加，請查照。

說明：

一、為鼓勵大專生、碩博研究生能在智慧製造智動化領域積極參與研究，且能學以致用，並增進產學合作融合，為產業培養機電整合、軟體設計、AI 應用等跨領域優秀的人才，特舉辦此項論文獎競賽。

二、比賽徵稿相關說明如次：

1. 初賽徵稿期限：即日起至 2023 年 9 月 4 日 PM 17:00 止。
2. 徵稿對象：全國各大專院校相關學系所在學或應屆畢業生。
3. 公布入圍決賽名單日期：2023 年 9 月 25 日(正取 10 隊，備取 5 隊)。
4. 決賽簡報與海報電子檔上傳日期：2023 年 10 月 5 日 PM 17:00 前。
5. 決賽日期：2023 年 10 月 14 日(六)(詳見競賽辦法)。
6. 活動網站：<http://www.saa-symtek.com>
7. 本競賽如有增修說明事宜，得隨時修正後另行公布，請以活動網頁最新公告為據。

三、本案主辦單位：迅得機械股份有限公司，召集人：人資部高偉經理，本案承辦單位：元智大學。

四、檢附迅得機械【智慧製造科技論文】競賽辦法、論文格式(附件一)及
參賽同意書(附件二)。

正本：公私立大專院校工學院及電資學院

附本：承辦單位：元智大學

協辦單位：TPCA 台灣電路板協會、中央大學、中原大學、健行科技大學

總經理 王年清